证券代码：688432 证券简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	234,682,549.22		-9.07
归属于上市公司股东的净利润	56,384,833.25		-26.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,332,356.81		-24.09
经营活动产生的现金流量净额	25,772,581.76		-51.01
基本每股收益（元/股）	0.05		-26.96
稀释每股收益（元/股）	0.05		-26.96
加权平均净资产收益率（%）	1.35		减少0.57个百分点
研发投入合计	21,554,957.60		-6.19
研发投入占营业收入的比例（%）	9.18%		增加0.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,036,344,600.11	5,043,056,336.86	-0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,171,320,232.31	4,147,998,364.82	0.56

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,791.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,947,168.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,038,665.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,222,912.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,684,555.33	
合计	19,052,476.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-51.01	主要系本报告期销售回款较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	0	0	无	0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无	0
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳诺河投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,500,000	1.80	22,500,000	22,500,000	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	19,554,490	1.57	19,554,490	19,554,490	无	0
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	其他	19,339,894	1.55	0	0	无	0
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	其他	13,034,204	1.04	0	0	无	0
中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）	其他	9,000,000	0.72	9,000,000	9,000,000	无	0
德州芯慧咨询管理中心（有限合伙）	其他	7,011,317	0.56	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国有研科技集团有限公司	230,422,500	人民币普通股	230,422,500
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	19,339,894	人民币普通股	19,339,894
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	13,034,204	人民币普通股	13,034,204
德州芯慧咨询管理中心（有限合伙）	7,011,317	人民币普通股	7,011,317
北京京国盛投资基金（有限合伙）	6,024,368	人民币普通股	6,024,368
华润微电子控股有限公司	5,020,307	人民币普通股	5,020,307
浙江晶盛机电股份有限公司	4,640,307	人民币普通股	4,640,307
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,732,033	人民币普通股	2,732,033
德州芯智咨询管理中心（有限合伙）	2,597,198	人民币普通股	2,597,198
德州芯鑫咨询管理中心（有限合伙）	2,046,696	人民币普通股	2,046,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RSTechnologies实际控制人为方永义。 2、RSTechnologies与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司1.27%的股份，持有研投基金2.15%的出资份额。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止报告期末，招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金通过转融通方式出借公司股票31,800股。		

注：有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年3月31日，"有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户"持股数为3,285,336股，占公司总股本的比例为0.26%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中信证券投资有限公司	18,787,990	1.51	766,500	0.06	19,554,490	1.57	0	0.00
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,932,033	0.24	31,800	0.00	2,732,033	0.22	31,800	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	退出	255,100	0.02	1,421,200	0.11
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	1,218,453	0.10
广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	退出	356,600	0.03	1,288,738	0.10
交通银行股份有限公司－华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	退出	275,900	0.02	1,088,637	0.09

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益或用于股权激励、员工持股计划。

截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,285,336股，占公司最新总股本的0.26%，最高成交价为10.70元/股，最低成交价为9.57元/股，支付的资金总额为人民币33,590,466.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见2024年2月21日和2024年4月2日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-020）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,370,691,912.86	1,504,386,200.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,480,554,301.36	1,351,953,493.15
衍生金融资产		
应收票据	35,417,428.14	67,004,744.53
应收账款	216,583,428.09	170,475,938.68
应收款项融资	69,260,389.66	52,353,799.21
预付款项	3,352,001.23	2,405,309.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	595,379.94	400,285.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,967,523.08	205,792,594.01
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,022,955.38	14,952,065.98
流动资产合计	3,369,445,319.74	3,369,724,430.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,205,587.89	385,336,730.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	994,678,301.15	1,014,009,928.15
在建工程	151,112,602.00	123,058,374.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,213,468.08	12,014,349.47
无形资产	82,006,023.63	82,746,540.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,974,709.49	3,272,180.43
递延所得税资产	5,707,943.67	5,764,273.64
其他非流动资产	8,000,644.46	17,129,528.79
非流动资产合计	1,666,899,280.37	1,673,331,906.04
资产总计	5,036,344,600.11	5,043,056,336.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,982,429.92	12,715,301.39
应付账款	83,357,319.87	102,190,351.23
预收款项		
合同负债	582,182.51	245,849.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,384,437.78	35,859,380.90
应交税费	12,067,236.76	8,624,792.48
其他应付款	63,504,913.48	64,330,432.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,377,343.91	4,309,800.10
其他流动负债		
流动负债合计	205,255,864.23	228,275,907.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,942,989.10	6,791,613.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	212,565,906.13	227,426,490.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,508,895.23	234,218,103.74
负债合计	423,764,759.46	462,494,011.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,541,111.98	2,250,624,106.66
减：库存股	33,590,466.48	
其他综合收益		
专项储备	6,849,254.96	6,238,759.56
盈余公积	25,250,365.27	25,250,365.27
一般风险准备		
未分配利润	674,648,908.58	618,264,075.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,171,320,232.31	4,147,998,364.82
少数股东权益	441,259,608.34	432,563,960.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,612,579,840.65	4,580,562,325.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,036,344,600.11	5,043,056,336.86

公司负责人：张果虎主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：李文彬

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	234,682,549.22	258,092,770.62
其中：营业收入	234,682,549.22	258,092,770.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,376,949.71	189,800,730.51
其中：营业成本	159,718,293.05	161,432,100.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	714,120.48	2,206,308.86
销售费用	3,062,143.41	3,277,504.67
管理费用	7,336,140.37	7,222,367.87
研发费用	21,554,957.60	22,976,228.76
财务费用	-8,008,705.20	-7,313,780.09
其中：利息费用	109,435.58	35,830.29
利息收入	8,079,399.92	8,484,280.19
加：其他收益	16,711,312.59	25,470,425.77
投资收益（损失以"-"号填列）	2,782,495.92	1,396,537.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,131,142.60	-2,342,086.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	3,125,027.38	3,211,310.50
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-718,879.12	-794,920.66
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,043,731.95	-2,984,003.97
资产处置收益（损失以"-"号填列）		18,648.55
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	73,249,288.23	94,610,037.40
加：营业外收入	1.09	31,769.03
减：营业外支出	25,891.96	137.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	73,223,397.36	94,641,669.43
减：所得税费用	9,505,188.00	8,438,775.30
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	63,718,209.36	86,202,894.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	63,718,209.36	86,202,894.13
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	56,384,833.25	77,232,418.34
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	7,333,376.11	8,970,475.79
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,718,209.36	86,202,894.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,384,833.25	77,232,418.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,333,376.11	8,970,475.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张果虎主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：李文彬

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,618,930.96	217,545,944.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,422,307.04	6,930,462.08
收到其他与经营活动有关的现金	12,115,591.71	27,320,727.01
经营活动现金流入小计	191,156,829.71	251,797,133.80
购买商品、接受劳务支付的现金	102,743,977.74	143,435,231.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,579,504.27	46,009,659.64
支付的各项税费	6,240,244.47	4,561,034.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,820,521.47	5,186,035.56
经营活动现金流出小计	165,384,247.95	199,191,961.34
经营活动产生的现金流量净额	25,772,581.76	52,605,172.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,480,000,000.00	658,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,437,857.69	4,092,920.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,491,441,257.69	662,092,920.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,184,235.15	18,506,190.37
投资支付的现金	2,610,000,000.00	1,944,879,708.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	3,840,000.00
投资活动现金流出小计	2,636,184,235.15	1,967,225,899.14
投资活动产生的现金流量净额	-144,742,977.46	-1,305,132,978.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,181,388.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,181,388.80	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,181,388.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,188,965.37	7,428,823.59
筹资活动现金流出小计	37,188,965.37	7,428,823.59
筹资活动产生的现金流量净额	-36,007,576.57	-7,428,823.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,899.77	-211,574.44
五、现金及现金等价物净增加额	-154,959,072.50	-1,260,168,203.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,477,120,831.11	2,342,613,183.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,161,758.61	1,082,444,979.86

公司负责人：张果虎主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：李文彬

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年4月25日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-022

有研半导体硅材料股份公司第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月19日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2024年第一季度报告。报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第一季报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年第一度报告》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司2024年第一度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王慧、田中利朗为有研半导体硅材料股份公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

议案3.01《关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案3.02《关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案及其子议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024年4月26日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-024

有研半导体硅材料股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月25日召开职工代表大会，选举李磊先生为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

李磊先生作为职工监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024年4月26日

附职工监事简历：

李磊先生简历

李磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2004年6月至2014年12月任国泰半导体材料有限公司职员、综合管理部副经理；2015年1月至今任公司总经理办公室副经理；2018年1月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司职工代表监事。

截至目前，李磊先生未直接持有公司股票。由于李磊先生目前在北京有研艾斯半导体科技有限公司担任职工代表监事，因此，与北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-025

有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届董事会将于2024年5月任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方永义先生、张果虎先生、薛玉檩先生、远藤智先生、矶贝和范先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

董事会提名委员会在对4名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选王慧女士、田中利朗先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年4月26日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、方永义先生简历

方永义先生，1970年出生，日本籍，博士。2010年12月至今任株式会社RSTechnologies法定代表人、董事长、总经理；2015年11月至今任台湾艾尔斯半导体股份有限公司法定代表人、董事长；2018年1月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司法定代表人、董事长；2018年8月至今任山东有研半导体材料有限公司董事长；2019年1月至今任株式会社DGTechnologies法定代表人、董事长、总经理；2020年3月至今任山东有研艾斯半导体材料有限公司董事长；2021年5月至今任公司董事长。

截至目前，方永义先生未直接持有公司股票。北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RSTechnologies实际控制人为方永义先生。株式会社RS Technologies与福建仓元投资有限公司已签署一致行动协议。除上述情况外，方永义先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、张果虎先生简历

张果虎先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2014年12月至今历任有研半导体硅材料股份公司（曾用名"有研半导体材料有限公司"）董事、执行董事、总经理、党总支书记；2018年1月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事；2018年8月至今任山东有研半导体材料有限公司副董事长兼总经理；2020年3月至今任北京艾唯特科技有限公司董事长；2021年5月至今任公司法定代表人、董事、总经理；2023年10月至今任艾唯特（德州）阀门科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，张果虎先生未直接持有公司股票。由于张果虎先生目前在北京有研艾斯半导体科技有限公司担任董事，因此，与北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，张果虎先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、薛玉檩先生简历

薛玉檩先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年6月至2023年8月历任有研粉末新材料股份有限公司（原"有研粉末新材料（北京）有限公司"）财务总监、董事会秘书、总法律顾问；2023年8月至今任中国有研科技集团有限公司运营管理部(安全环保部)总经理。

截至目前，薛玉檩先生未持有公司股票。由于薛玉檩先生目前在中国有研科技集团有限公司任职，因此，与中国有研科技集团有限公司存在关联关系。除上述情况外，薛玉檩先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、远藤智先生简历

远藤智先生，1971年出生，日本国籍，毕业于国立一关工业高等专业学校。2017年4月至今任株式会社RS Technologies制造部部长及董事；2023年7月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事；2023年7月至今任公司董事；2023年8月至今任山东有研半导体材料有限公司董事。

截至目前，远藤智先生未直接持公司股票。由于远藤智先生目前在控股股东株式会社RS Technologies任职及担任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事，因此，与株式会社RS Technologies、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，远藤智先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

5、矶贝和范先生简历

矶贝和范先生，1977年出生，日本国籍，硕士研究生学历。2013年5月至2015年4月借调至日本经济产业省工业技术与环境局国际标准司担任电子司科长；2013年5月至2023年12月历任松下电器公司市场总部战略规划部科长、企业战略部副总监兼任风险投资策略办公室副总监、中国东北亚公司（北京）企业企划中心副总监兼投资部长、生活家电公司企业企划中心副总监；2024年1月至今任株式会社RS Technologies企业企划部部长；2024年2月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司总经理。

截至目前，矶贝和范先生未持有公司股票。由于矶贝和范先生目前在控股股东株式会社RS Technologies及北京有研艾斯半导体科技有限公司任职，因此，与株式会社RS Technologies、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，矶贝和范先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

1、钱鹤先生简历

钱鹤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年1月至今任清华大学集成电路学院教授；2021年5月至今任公司独立董事；2021年6月至2023年6月任天津新忆智能科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年4月至今任兆易创新科技集团股份有限公司（603986.SH）独立董事；2023年6月至今任天津新忆智能科技合伙企业（有限合伙）合伙人。

截至目前，钱鹤先生未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、孙根志华先生简历

孙根志华先生，1962年出生，日本国籍，博士研究生学历。1996年4月至今曾先后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授；2023年7月至今任公司独立董事。

截至目前，孙根志华先生未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、邱洪生先生简历

邱洪生先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理；2020年11月至今任西藏长盛投资管理有限公司执行董事兼总经理；2021年4月至今任中节能万润股份有限公司（002643.SZ）独立董事；2021年5月至今任公司独立董事；2021年9月至今任中国长城科技集团股份有限公司（000066.SZ）独立董事。

截至目前，邱洪生先生未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、袁少颖女士简历

袁少颖女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年4月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2021年5月至今任公司独立董事。

截至目前，袁少颖女士未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

1、王慧女士简历

王慧女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至今历任中国有研科技集团有限公司（原"有研科技集团有限公司"）会计、财务金融部副主任、财务监管处处长、财务金融部总经理；2018年6月至今任厦门火炬特种金属材料有限公司董事；2019年4月至2022年1月任南京驰韵科技发展有限公司董事；2020年5月至2022年1月任有研粉末新材料股份有限公司监事会主席；2020年7月至2021年12月任有研工程技术研究院有限公司董事；2020年11月至今分别任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事会主席、山东有研艾斯半导体材料有限公司监事；2021年5月至今任公司监事会主席。

截至目前，王慧女士未持有公司股票。由于王慧女士目前在中国有研科技集团有限公司任职及担任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事，因此，与中国有研科技集团有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、田中利朗先生简历

田中利朗先生，1970年出生，日本国籍，大学学历。1993年4月至2022年10月任职于三菱日联银行；2022年11月至2023年12月任株式会社RSTechnologies经营企划室主管；2023年12月至今任株式会社LE SYSTEM董事；2023年7月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事；2023年7月至今任公司监事。

截至目前，田中利朗先生未持有公司股票。由于田中利朗先生目前在控股股东株式会社RS Technologies的子公司任株式会社LE SYSTEM担任董事及任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事，因此，与株式会社RS Technologies、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-023

有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"集成电路用8英寸硅片扩产项目"、"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号)，同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)187,143,158股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2022年11月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2024年3月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具体投入情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金累计投入比例
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	384,824,300.00	119,305,526.97	31.00%
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	357,347,600.00	61,336,440.04	17.16%
3	补充研发与运营资金	257,828,100.00	144,769,552.69	56.15%
合计		1,000,000,000.00	325,411,519.70	-

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预计达到可使用状态时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态时间	变更后项目达到预定可使用状态时间
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	2024年5月	2025年12月
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	2024年11月	2025年12月

（二）本次募投项目延期的原因

公司对部分募投项目进度适当调整主要基于以下因素：第一，受市场需求变动的影响，公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化，使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二，本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则，公司适当调整了投资节奏。"集成电路用8英寸硅片扩产项目"分两个阶段执行，目前第一阶段5万片/月的产能已经建设完毕，公司8寸硅片产能已达到18万片/月，且保持了较高的产能利用率；同时，第二阶段建设已经启动。"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"受厂房设计及招投标等客观因素影响，开工较预期延迟。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将"集成电路用8英寸硅片扩产项目"、"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"达到预定可使用状态的日期均调整至 2025年12月。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对募投项目"集成电路用8英寸硅片扩产项目"、"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目必要性分析

随着物联网、人工智能、汽车电子和区块链等新兴技术的快速发展及移动终端的普及，半导体硅材料的应用呈多元化趋势。公司的集成电路用8英寸硅片及集成电路刻蚀设备用硅材料等产品在下游客户应用得到快速发展，获得了大量高品质客户的认可。为适应市场需求，公司积极推进并实现半导体硅材料的国产化，故急需增加生产线，实现增量扩产，公司募投项目已布局此细分领域，亟待抢占市场份额。公司通过扩大生产规模，增加原材料需求量，提升面对上游供应商的议价能力，从而有效降低材料成本，拉升公司整体毛利率水平，提升公司盈利能力，满足其对利润增长的需求。

（二）项目可行性分析

本项目符合《国家集成电路产业发展推进纲要》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等国家相关政策的规定。公司扎实稳健的技术积累为项目建设提供了坚实的保障，同时也培养造就了一批科技创新及经营管理人才，现有管理团队均拥有多年行业从业经验。优质、稳定的下游合作商为产能消化提供助力，积极推动企业扩大生产规模、提高产能、产能消化等进程。

（三）募集资金投资项目论证结论

公司认为募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

五、公司履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司"集成电路用8英寸硅片扩产项目"、"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等。保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人同意公司本次募投项目延期事项。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司

董事会

2024年4月26日